AI産業分析レポート（第1弾）

AIインフラ 2026～2030：どこにボトルネックと利益が移るのか

―GPU・HBMから電力・冷却・データセンターまで、日本企業の参入機会を読む―

■ AIの普及は、GPUやHBMだけでなく電力・冷却・ネットワーク・データセンター・材料・装置・運用までを一気に再編しつつあります。
本レポートは、**AIインフラの主要レイヤー約100社**を横断し、**2026年～2030年にどの領域で供給制約が生じ、どこに利益プールが移る**のかを分析します。
競争優位・依存関係・提携構造・日本企業の参入機会を整理し、経営企画・事業企画・事業開発のご担当者が、AI関連事業への参入、提携、投資、製品開発を検討する際の判断材料としてご活用いただけます。

■ 以下のような課題をお持ちの企業様におすすめです。
① AIデータセンター関連へ参入すべきか、参入するならどの領域かを判断したい
② 電力、冷却、ネットワーク、サーバー、材料のどこに投資と受注機会が集中するか知りたい
③ NVIDIA、ハイパースケーラー、データセンター事業者などの関係構造から、自社の提携・営業戦略を立てたい
④ 2030年に向けたAI関連事業の優先順位と投資判断の材料が欲しい

【調査主旨・目的】
- 本調査は、AIモデルの学習・推論・提供を支えるAIインフラについて、各レイヤーの市場成長だけでなく、供給制約、投資負担、価格決定力、利益プール、企業間の依存関係を分析する。
- GPU・HBM・先端パッケージから、AIサーバー、ネットワーク、データセンター、電力、冷却、関連設備までを横断し、2026年～2030年にかけて、どの領域がボトルネックとなり、どこに収益機会が移るのかを明らかにする。
- なお、本調査は「AI産業分析調査レポート」の第1弾としてAIインフラ産業を調査対象とし、第2弾としてAIサービス（フィジカルAI等）を調査対象とする。

【本レポートで解決できる課題】
- AI関連事業へ参入すべきか、参入するならどの領域から着手すべきか判断したい
- 自社の部材・装置・技術が、AIデータセンター市場で不可欠性を持つかを評価したい
- 電力、冷却、ネットワーク、サーバー、材料のどこに投資機会と受注機会が集中するか見極めたい
- 主要プレイヤーの提携・出資・長期契約から、自社のポジションと提携戦略を評価したい

【定義】
- 本レポートでは、AIインフラを広く、AIデータセンターをその中核領域として扱うこととする。
- 本調査におけるAIインフラとは、AIモデルの学習・推論・提供を支える計算資源、半導体、メモリ、パッケージ、サーバー、ネットワーク、データセンター、電力、冷却および関連設備を指す。
- AIアプリケーション、基盤モデルそのもの、一般的なITサービスは原則として対象外とする。
  AIデータセンター市場は、AIワークロードを処理するデータセンターの建設・設備・電力・冷却・ネットワーク・運用サービスを対象とし、GPU・HBM・ASIC等は構成要素として別掲とする。

【調査範囲】

- 本調査は、AIインフラ産業関連の**主要企業約100社**を分析し、「全体俯瞰」と「重点分析」に分けて実施する。
  重点企業については、事業領域、製品・技術、顧客・供給網、投資計画、提携・長期契約、競争優位、リスク要因を整理する。
  また、単なる企業・市場の列挙にとどめず、**主要レイヤーごとのボトルネック、利益プール、代替性、日本企業の参入余地**を横断比較する。
- 全体俯瞰：AIインフラの6レイヤー、主要企業、需要構造、供給制約、企業間の提携・出資・長期契約、資金と価値の流れを整理する。
- 重点分析：①AIアクセラレーター・HBM・先端パッケージ、②AIサーバー・ネットワーク・光通信、③AIデータセンター・電力・冷却、④日本企業の競争力と事業機会を深掘りする。

【本レポートで分かること】

- AIインフラのどのレイヤーで供給制約が発生し、今後どこへ移る可能性があるか
- GPU・HBM・先端パッケージ、電力・受変電、冷却、ネットワーク、データセンターにおける市場規模、需給、投資、競争構造
- 主要企業の競争優位、顧客依存、提携・出資・長期契約、垂直統合の動向
- レイヤー別のコスト構造、価格決定力、収益性、利益プールの変化
- 日本企業が競争優位または不可欠性を持ち得る部材、装置、電力機器、冷却、光通信、運用領域
- 自社の事業領域と照らし合わせて検討すべき、参入・提携・投資・製品開発の候補領域および評価の視点

【主な成果物】

- AIインフラの全体像・バリューチェーン俯瞰図
- レイヤー別の市場規模、成長性、需給・投資動向
- ボトルネック・重要度マップ（供給制約、代替性、価格決定力、投資負担、技術変化リスク、日本企業の参入余地から評価）
- 主要企業約100社のポジショニング・関係性整理
- レイヤー別のコスト、収益、価格決定力、利益プール分析（CapEx・OpEx、収益モデル、2026年・2030年の利益プール移動を比較）
- 日本企業の競争力・不可欠性評価
- 有望事業機会のポジショニングおよび優先順位
- 2026年～2030年のシナリオ分析

【調査期間・納品時期】

- 調査期間：2026年11月～2027年2月中旬
  納品時期：2027年2月下旬頃（予定）　※成果物はPDFで納品します。

章	章テーマ	章の問い	項目ID	調査項目	分析区分	調査対象・範囲
第1章	AIデータセンターの定義と需要構造	AIデータセンターは何で構成され、何が需要を生むのか	1-1	AIデータセンター市場の定義・対象範囲	全体俯瞰	建設・設備、AIサーバー・ラック、ネットワーク・ストレージ、電力・冷却、運用・サービス、AIコロケーション・GPUクラウド。GPU・HBM・ASIC等は本体市場から除外し参考値として別掲。
			1-2	AIインフラの全体構造とAIデータセンターの位置付け	全体俯瞰	AIデータセンター、半導体、ネットワーク、電力、冷却、クラウド、通信、ソフトウェア、データ、エッジAI
			1-3	学習・推論・企業AI・エッジAIの需要ドライバー	全体俯瞰	大規模学習、大規模推論、企業AI、AIクラウド、オンプレミス、エッジAI
			1-4	重点事業機会の仮説	全体俯瞰	AIデータセンター建設・設備、電力・受変電、冷却、サーバー、ネットワーク、半導体、クラウド、エッジAI等
第2章	AIデータセンター市場と投資の全体像	AIデータセンター市場はどの程度で、何が投資を動かすのか	2-1	AIデータセンター市場の定義・市場規模	全体俯瞰	世界、日本、主要地域。建設・設備、AIサーバー・ラック、ネットワーク・ストレージ、電力・冷却、運用・サービス、AIコロケーション・GPUクラウド
			2-2	投資主体とCapEx動向	全体俯瞰	ハイパースケーラー、GPUクラウド、通信、DC事業者、政府、企業ユーザー
			2-3	インフラ形態別需要	全体俯瞰	ハイパースケール、コロケーション、GPUクラウド、オンプレミス、エッジ
			2-4	2030年シナリオ	全体俯瞰	AI利用、電力、投資、規制、供給能力、AIデータセンター容量
第3章	成長を制約するボトルネック	AIデータセンターの成長を制約する希少資源は何か	3-1	ボトルネック総合評価	全体俯瞰	GPU、HBM、先端パッケージ、サーバー、ネットワーク、DC、電力、冷却、通信、人材
			3-2	AIアクセラレーター・メモリ・先端パッケージ	重点分析	GPU、ASIC、HBM、DRAM、先端パッケージ、基板、ファウンドリ

			3-3	AIサーバー・ラック・ネットワーク・光通信	重点分析	AIサーバー、ラック、スイッチ、光トランシーバー、ケーブル、ODM/OEM、DCI
			3-4	電力・送配電・受変電	重点分析	発電、送電網、変圧器、スイッチギア、UPS、蓄電、配電
			3-5	冷却・熱管理	重点分析	空冷、直接液冷、浸漬冷却、CDU、熱交換器、チラー、ポンプ
			3-6	ボトルネックの移動・陳腐化リスク	全体俯瞰	全レイヤー、技術世代、設備更新、電力・冷却
第4章	AIデータセンターの成立条件	AIデータセンターをどこに、どの仕様で、どの程度整備できるか	4-1	AIデータセンターの技術要件	重点分析	ハイパースケール、GPUクラウド、コロケーション
			4-2	立地・用地・許認可	重点分析	主要国・地域、日本の主要候補地域
			4-3	投資構造と建設リードタイム	重点分析	建物、受変電、冷却、ネットワーク、サーバー
			4-4	電力接続・稼働化・収益性リスク	重点分析	DC事業者、電力会社、受変電設備、GPUクラウド
			4-5	環境・レジリエンス	全体俯瞰	電力、水、BCP、災害、停電、サイバー
第5章	エコシステムと競争構造	誰が主導権を握り、どこで囲い込みが進むのか	5-1	AIデータセンター・AIインフラのエコシステム全体像	全体俯瞰	半導体、装置、材料、サーバー、ネットワーク、DC、電力、冷却、建設、運用、クラウド、ソフトウェア、エッジ
			5-2	主導企業・競争構造	全体俯瞰	主要グローバル企業・国内企業

			5-3	重要提携・M&A・長期契約	全体俯瞰	主要企業の公表案件
			5-4	垂直統合・隣接進出・依存度・代替性	全体俯瞰	半導体、クラウド、DC、電力、冷却、ソフトウェア企業
第6章	コスト・収益・利益プール	投資資金はどこに向かい、どの事業で利益が残るのか	6-1	CapEx・OpEx構造	重点分析	計算資源、サーバー、ネットワーク、DC、電力、冷却、運用
			6-2	レイヤー別の収益モデル・収益性	重点分析	半導体、サーバー、ネットワーク、DC、電力機器、冷却、クラウド、運用
			6-3	価格決定力	全体俯瞰	主要レイヤー・主要企業
			6-4	利益プールの方向性	重点分析	主要レイヤー、2026年・2030年
第7章	日本企業の競争力と事業機会	日本企業はどの領域で不可欠な存在になれるのか	7-1	日本企業の現在地	重点分析	材料、装置、電子部品、光通信、電力機器、冷却、DC、運用、ソフトウェア、エッジ
			7-2	競争優位と持続性	重点分析	重点日本企業・海外競合
			7-3	事業機会の投資環境評価	重点分析	AIデータセンター建設・設備、電力・受変電、冷却、サーバー、ネットワーク、半導体、クラウド、エッジAI等
			7-4	不可欠性評価	重点分析	重点部材、装置、電力機器、冷却、運用、ソフトウェア
			7-5	事業機会ポジショニング・優先順位	重点分析	重点事業機会、日本企業の関連領域

【調査対象企業】

NVIDIA	NTT	富士フイルム	CoreWeave	IHI
Advanced Micro Devices	フジクラ	Coherent	村田製作所	OpenAI
Intel	古川電工	TSMC	TDK	Anthropic
Samsung Electronics	Corning	Amkor Technology	太陽誘電	xAI
SK hynix	ASML	Super Micro Computer	ニデック	Constellation Energy
Micron Technology	東京エレクトロン	Dell Technologies	三菱電機	NextEra Energy
キオクシア	Lam Research	HP	富士電機	Bloom Energy
SanDisk	KLA	富士通	明電舎	KOKUSAI ELECTRIC
Qualcomm	ディスコ	NEC	東芝	Hugging Face
Broadcom	スクリーン	日立製作所	Infineon Technologies	Tenstorrent
Marvell Technology	アドバンテスト	レノボ	テキサスインスツルメンツ	Western Digital
Microsoft	Applied Materials	Quanta Cloud Technology	ローム	Cerebras Systems
Google	信越化学工業	Cisco	ルネサス	Groq
Meta Platforms	東京応化	Arista Networks	ダイキン工業	SambaNova Systems
Amazon	JSR	Juniper Networks	ジョンソンコントロールズ	Lightmatter
Alibaba	SUMCO	ファーウェイ	シュナイダーエレクトリック	Celestial AI
Tencent	住友化学	Equinix	三菱重工	
Baidu	レゾナック	NTTファシリティーズ	川崎重工業	

など

※企業名は、各社の一般的な通称・ブランド名を含む略記で表記しています。

お申込書

	AI産業分析レポート（第1弾） **AIインフラ 2026～2030：どこにボトルネックと利益が移るのか** **―GPU・HBMから電力・冷却・データセンターまで、日本企業の参入機会を読む―**
	価格： **165,000円（税込）** 調査期間： 2026年11月～2027年2月中旬 納品時期： 2027年2月下旬を予定 納品形式： PDF
※貴社名	
※御所属	
※御名前	
※メールアドレス	
見積書	□ 希望する　見積書をご希望の場合は、左記にチェックを入れてください。
領収書	□ 希望する　領収書をご希望の場合は、左記にチェックを入れてください。
ご要望・ご質問 （ご希望の調査テーマ等ございましたら、ご記載ください。）	

※は必須項目です。

・調査費用のお支払方法：請求書発行時に銀行振込（請求書はレポート納品時に同封します）

・ご請求書は御社既定のお支払条件にて作成いたします。

・納品物は**PDFのみでのご提供**となります。（書籍でのご提供は対応しておりません。）

・PDFは、お申し込みいただいた法人内での閲覧・共有にご利用いただけます。社外への再配布・転載はご遠慮ください。

・お申し込み後のキャンセルは、調査開始日（2026年11月9日）前までにご連絡ください。
　調査開始後のキャンセルについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。

お申し込みの際には、上記申込書をご記載の上、**2026年11月06日（金）までに**下記のメールアドレス宛に
ご返信をお願い申し上げます。

※ご記入いただいた情報は、本調査に関するご連絡、請求・納品業務、および今後の調査・セミナーのご案内の
目的に限り利用いたします。

合同会社トリプルライズ
企画担当：三上秀嗣
hidetsugu.sanjo@triple-rise.co.jp